

耐熱イミド基材半導体チップ固定用テープ

278

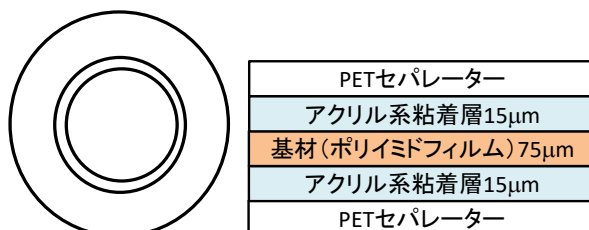
特徴

- ①半田耐熱性ポリイミドフィルムを基材にした耐熱両面テープ
- ②ガラス・半導体への糊残り性に優れている
- ③優れた長期耐熱性

用途

自動車のエンジン回りや航空宇宙機器などの部品固定

構成



特性

一般特性

製品名	(基材厚み) (mm)	(粘着厚み) (mm)	粘着力 (N/25mm)
278	0.075	0.030	5

測定条件	引張速度	300mm/min	
(JIS Z0237準拠)	引張角度	180度	貼り合わせ後、1時間後の測定値
	測定温度	23℃	被着体 ステンレス板

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
- 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。

保管の注意

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>

2020年5月22日 発行